

LCP 日本上野 2530G BK连接器专用LCP塑胶原料欢迎咨询

产品名称	LCP 日本上野 2530G BK连接器专用LCP塑胶原料欢迎咨询
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

聚甲醛在机械制造行业用来制造机床电动机保护开关、润滑剂万向导管、磨床叶轮、外圆磨床液压套筒等。农业机械：手动喷雾器部件，播种机的连接和联运部件，挤乳机的活动部件，排灌水泵壳，进出水阀座、接头和套管等。还可用于气溶胶的包装、输送管、浸在油中的部件及标准电阻面板等。

COC是新型的具有环状烯烃结构的非晶性透明共聚到分子材料,其具有作为光学部件非常重要的低双折射率以及低吸水性高刚性等优良性能.

尼龙-66。一种热塑性树脂，白色固体，密度1.14，熔点253，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大，可用作工程塑料。洛氏硬度108-118，热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/厘米2）66-86。用作机械附件，如齿轮、润滑轴承；代替有色金属材料做机器外壳，汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。

本公司品种，货源充足，产品原厂原包，，批量采购，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

LCP塑胶原料密度为1.4~1.7g/cm3。液晶聚合物具有高强度，高模量的力学性能，由于其结构特点而具有自增强性，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平；如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。

热塑性塑料(Thermo plastics)：指加热后会熔化，可流动至模具冷却后成型，再加热后又会熔化的塑料，即可运用加热及冷却，使其产生[可逆变化](液态 固态)，是所谓的物理变化。

有些塑料是可燃的;

绝缘材料：PEEK因具有优良的电气性能，在高温、高湿等恶劣条件下，聚醚醚酮的绝缘性能仍能保持，是理想的电绝缘材料，特别是在半导体工业中得到广泛应用。

塑胶原料一词的英文“ plastic ”原意为可任意捏成各种形状的材料或可塑材料。而在辞海中被定义为“ 以合成的或天然的高分子化合物为主要成分 ”，可在一定条件下塑化成型，产品保持形状不变的材料。

聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100 ° C温度范围内长期使用。

燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。

塑胶原料受热膨胀,热胀系数比金属大很多;

液晶聚合物分子的分之主链刚硬，分子之间堆砌紧密，且在成型过程中高度取向，所以具有线膨胀系数小，成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性，具有较高的负荷变形温度，有些可高达340 以上。

POM（ 又称赛钢、特灵 ）。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H（ 聚甲醛均聚物 ），POM-K（ 聚甲醛共聚物 ）是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有的性能。POM属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长，会引起分解。铜是POM降解催化剂，与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。

LCP塑胶原料的特性；

a、 LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。

b、 液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

c、 LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。

d、 LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。

e、 LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

a、 电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（ 能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接 ）。

b、 LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。

c、 LCP加入高填充剂或合金（ PSF/PBT/PA)作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料； 作光纤电缆接头护套和高强度元件； 代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的

聚砒等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。